

平成15年10月14日

委員 各位

日本学術振興会  
「結晶加工と評価技術」第145委員会  
委員長 梅野 正隆

## 日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第145委員会 第98回研究会

- (1) 日時 平成15年12月2(火)13:10-17:00  
(2) 場所 主婦会館プラザエフ 4F シャトレ TEL:03-3265-8111 <http://www.plaza-f.or.jp/>  
JR中央線 四ッ谷麴町口、地下鉄丸の内線/南北線 四ッ谷駅  
(3) 研究会 テーマ「ウェーハ平坦性、ナノトポグラフィー、CMP」

世話人 小山 浩(日本電子)、土肥俊郎(埼玉大学)、福田哲生(富士通)

**趣旨** 90nm 量産デバイスや 65nm 開発デバイスのプロセスインデグレーションにおいて、ウェーハ平坦性およびナノトポグラフィーは、リソグラフィーやCMPに直接影響するため、これまでになく重要な技術課題となっている。さらに、各社ウェーハプロセスの共通化も求められ始めており、これら技術課題の基礎を見直し、その技術動向を概観することは大変意味がある。このような背景の下に、第145委員会では上記の課題を、ウェーハプロセス、ウェーハ製造、計測ならびに標準化の視点で捉え、研究会を開くことにした。CMPの基礎については、米国の第一人者にも講演して頂くことにした。

多数の研究者、技術者、その他関係者のご参加ならびに講演会での活発な討論を希望いたします。

### スケジュール

- 13:10-13:15 委員長挨拶
- 13:15-14:15 招待講演 アリゾナ大 Philipossian 教授  
「CMP fundamentals(仮題)」
- 14:15-14:45 (株)ルネサステクノロジー 松川和人氏  
「デバイスプロセスから見たウェーハ平坦性の課題」
- 14:45-15:15 三菱住友シリコン(株) 森田悦郎氏  
「ウェーハ製造プロセスと平坦度の課題」
- 15:15-15:30 休憩
- 15:30-16:00 富士通(株) 福田哲生氏  
「300mm フラットネスの課題と標準化」
- 16:00-16:30 日本エーディーイー(株) 吉瀬正典氏  
「ウェーハ平坦度計測技術」
- 16:30-17:00 (株)荏原製作所 大野勝俊氏  
「ナノトポグラフィーがCMPに及ぼす影響」

注：学振委員以外の方のご出席も歓迎しますが、資料(予稿集)代として¥1,000円お支払い頂きます。